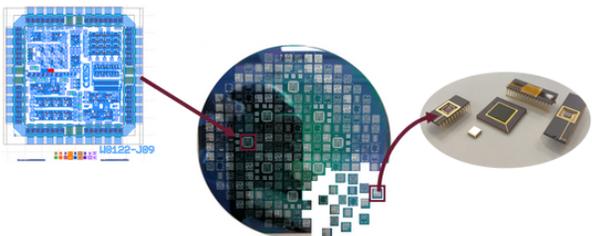


# Infraestructura y Servicios:

- Depósito de materiales y películas delgadas.
- Ataque seco por plasma.
- Procesamiento húmedo.
- Procesamiento térmico.
- Fotolitografía.
- Inspección y caracterización.
- Corte de obleas.
- Ensamble y empaquetamiento de semiconductores (ATP).
- Caracterización eléctrica.
- LPFE - Pruebas de principios físicos especiales.

## OBLEA MULTI-PROYECTO



Múltiples diseños integrados por CIDESI y fabricado con un proceso CMOS.



 [microtecnologias@cidesi.edu.mx](mailto:microtecnologias@cidesi.edu.mx)

 +52 (442) 211 98 00 Ext. 5068

 <https://cidesi.com>

 Av. Playa Pie de la Cuesta 702.  
Desarrollo San Pablo, Santiago de Querétaro Querétaro, México



Laboratorio Nacional de Micro y Nano Tecnologías

 **Ciencia y Tecnología** |   
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

**Ciencia y Tecnología**

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



**CIDESI**

## Laboratorio de Semiconductores y Microtecnologías



**Cuarto Limpio, 360 m<sup>2</sup>, operación alineada con ISO 9001 e ISO 14644**

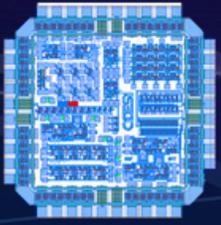
### Vocación:

Impulsar el diseño y desarrollo de productos basados en Semiconductores a través de la generación y aplicación de conocimiento de vanguardia, en estricto apego a las normas y estándares de calidad aplicables al Sector.

# MODELOS OPERATIVOS

## FABLESS

Diseño de Circuitos Integrados



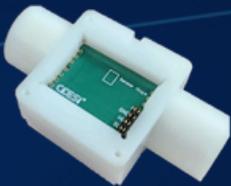
## FAB LITE

Estrategias híbridas de microfabricación (IN/OUTSOURCING)



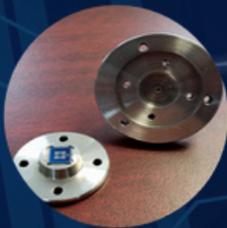
## IDM

Gestión integrada de procesos de fabricación



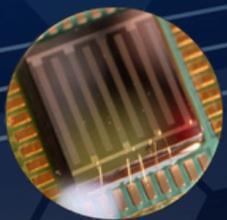
## OEM

Soluciones para fabricantes de equipos



## OSAT

Empaquetado y ensamble orientado a producto final



Código QR

Video

Laboratorio de Semiconductores y Microtecnologías

# DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

- Diplomado en semiconductores y procesos de fabricación.
- Consultoría especializada en diseño de microdispositivos.
- Maduración de proyectos (TRL's).
- Planificación y diseño de productos (PDP).
- Diseño a nivel sistema (MBSE).

# INVESTIGACIÓN APLICADA:

Materiales y procesos alternativos en microfabricación.

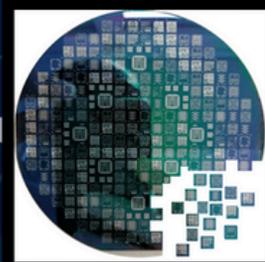
Modificación fisicoquímica de superficies.

Arquitectura de microsistemas digitales y analógicos.

Circuitos neuromórficos y cuánticos.

## Ensamble, prueba y empaquetado (ATP)

Oblea terminada



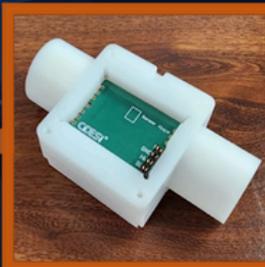
Caracterización a nivel de semiconductor



Corte de oblea



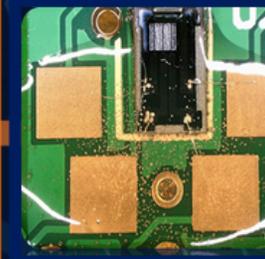
Ensamble



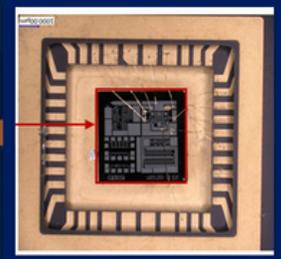
Producto terminado



Verificación y prueba de circuito integrado



Encapsulado



Alambrado

Laboratorio de caracterización eléctrica

Área de ensamble en cuarto limpio y área de manufactura